

证券代码：603893

证券简称：瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2025年3月)

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位	(排名不分先后) 华泰证券、国金证券、中信建投证券、华福证券、长江证券、东北证券、民生国联证券、红土创新基金、博时基金、永赢基金、中邮基金、易方达基金、泰康资产、前海人寿保险、UG fund
时间	2025年3月
地点	现场调研、电话会议
接待人员	证券部经理：陈楚毅（部分场次） 证券部副经理：王家珺 投资者关系：周颀
投资者关系 活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司介绍</p> <p>公司相关接待人员向投资者介绍了公司基本信息、主营业务、AIoT 发展特点、公司经营情况后，进入问答交流环节。</p> <p style="text-align: center;">二、交流环节</p> <p>1、目前看今年一季度订单情况如何？</p> <p>回答：目前订单情况良好，AIoT 发展趋势仍在延续。公司产品布局覆盖下游 AIoT 各产品线中多层次的性能需求，不同档位芯片之间具有很好的协同效应，并与周边芯片形成“网格”发展。</p> <p>2、产品布局方面，公司今年计划推出哪些新产品，主要的应用方向？</p> <p>回答：今年公司针对 AIoT 通用算力平台以及视觉、音频等专用领域，均将进一步推出新款智能应用处理器，完善现有产品矩阵。同时，公司坚持“阴阳互辅”的发展策略，将继续对电源管理芯片、接口芯片、无线连接等周边芯片进行研发和迭代。此外公司计划推出协处理器芯片，进一步满足边缘侧、端侧设备的 AI 算力升级、运行大模型的需求，助力人工智能技术在各行各业的落地应用。</p> <p>3、公司协处理器芯片当前进度如何？采用什么工艺制程？</p> <p>回答：公司协处理器芯片目前研发进展顺利，该类型产品未来将成为公司新的重要产品系列之一。公司会综合考虑实际的应用场景需求、成本以及</p>

功耗等因素来选择合适的芯片工艺制程，目前相关信息尚未对外发布，请您关注公司后续官网发布的产品信息。

4、公司芯片有计划采用 RISC-V 的内核吗？

回答：公司芯片目前以 ARM 架构为主，部分 SoC 芯片会局部使用 RISC-V 模块代替 MCU 做一些内部控制，包括外设控制和低功耗设计等，达到整体提高 SoC 芯片系统性能并在部分场景下有效的控制功耗，目前公司也有基于 RISC-V 架构的新品在研。

5、现在哪些领域看到 AI 端侧落地的趋势明显？

回答：随着 AIoT 市场不断发展，接入云端的边、端侧设备数量指数级增长，为应对云端运维成本攀升压力，并满足边、端侧设备对数据隐私保护和低时延、离线运行的需求，大模型规模化落地边、端侧应用的进程正在加速。当前已有多个领域的客户基于瑞芯微主控芯片研发在端侧支持 AI 大模型的新硬件，例如教育平板、AI 玩具、桌面机器人、会议主机、边缘计算等产品。随着 AI 大模型在教育、家庭、医疗、工业、农业、服务业等边缘、端侧场景中持续加速落地，未来将赋能更多样的边、端侧 AIoT 产品。

6、公司在机器人产品线上合作有多少客户？

回答：公司与多种形态的机器人场景中的多家客户均有合作，机器人是公司重点发展的产品线。公司在 AIoT 领域产品矩阵齐全，已有多款 SoC 芯片应用在多种形态的机器人产品，如各类工业机器人、服务机器人、仓储物流机器人、陪护机器人、娱乐机器人、清洁相关如除草/铲雪机器人、四足机器人等等，机器人行业整体市场需求仍在高速发展。

7、公司汽车音频方案有什么竞争优势？

回答：目前公司在车载音频领域布局了两款数字音频处理器 RK2118M、RK3308M 及高性能 Class D 数字音频功放 RK751M，可搭配应用于汽车音频方案中。其中，RK2118M 集成多核高性能 DSP，搭载音频专用 NPU，能够高效地运行各类音频算法，如人声分离/增强、乐声分离、AI 降噪、ECNR、虚拟环绕音等，有助于打造静谧的座舱环境、沉浸式的声学体验，满足行业客户对车内音效升级的需求。RK2118M 自 2024 年 3 月发布后，经过近一年时间的推广，已经与众多头部车厂、Tier1 厂商达成合作，在 2024 年已有项目快速量产落地。后续公司将进一步完善车载音频芯片布局，形成多层次产品方案，协同发展。

8、工业市场是否看到有明显复苏趋势？公司有布局海外客户吗？

	<p>回答：工业市场整体需求相对稳定，同时我们明显看到自动化、智能化需求在持续提升。今年 3 月公司携全系列工控芯片方案及商用案例参加了德国嵌入式展，设 HMI、PLC、工业网关、机器视觉、端侧 AI、软件技术与生态合作伙伴七大展区，展现 AI 赋能工业自动化多场景应用的硬实力，以及向全球开发者展示完善生态支持的软实力。目前公司工业产品解决方案正全面进军国际一流品牌，市场影响力稳步提升。</p> <p>9、近期有多家半导体公司公布了收并购、再融资等安排，公司短期内是否有收并购、再融资的计划？</p> <p>回答：公司结合战略发展、市场情况变化等因素综合考量收并购及再融资的需要，对于能给予公司战略协同效应的资产，公司一直在密切关注。感谢您对公司的关注！</p> <p>10、公司新发的股权激励计划激励对象只有 7 个人，主要是什么原因？</p> <p>回答：公司将股权激励作为常态化激励机制，会持续推出较大规模股权激励，其中穿插补充特殊的针对少数骨干员工的股权激励安排。因此作为补充的一期激励计划，公司向新引进的人才以及包括新聘任的公司高级管理人员在内的核心技术人员、技术骨干人员、业务骨干人员共计 7 人授予股票期权。后续公司仍将持续推出常态化的股权激励计划，充分激发各级员工的积极性，增强公司凝聚力，实现员工与公司共同成长。</p>
<p>时间</p>	<p>2025 年 3 月 31 日</p>
<p>备注</p>	<p>交流过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，不存在透漏任何未公开重大信息的情形。</p>